

证券代码：601231  
转债代码：113045

证券简称：环旭电子  
转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会活动记录

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>时间</b>	2024 年 11 月 12 日
<b>地点</b>	同顺路演平台 <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a>
<b>上市公司 参会人员</b>	黄江东（独立董事）、郭薇（独立董事）、史金鹏（董事会秘书）、吴新宇（财务长）
<b>业绩说明会 Q&amp;A 记录</b>	<p><b>【问题】</b> 请问公司在苹果公司以外的客户，SiP 业务拓展的情况</p> <p><b>【回答】</b> 公司一直在积极拓展新的应用领域以及“关键新客户”。除了新一代的通讯技术以及消费电子的智能化升级对 SiP 模组产品的需求增长外，SiP 模组的应用场景在增长，比如：在智能座舱的应用场景，环旭电子和多家车用的 SoC 方案厂商一起合作开发了车用运算模块，采用 SiP/SoM 模组，公司与笔记本电脑品牌厂商华硕合作开发了业界首创的 CPU SiP 模组。</p> <p><b>【问题】</b> 此次央行发布“回购增持专项贷款”且证监会也即将发布“上市公司市值管理指引”，由于公司目前的股价处于板块垫底的阶段，公司是否有考虑过利用此次的政策优惠贷款再进行增持回购注销呢？</p> <p><b>【回答】</b> 公司 2019 年以来已完成 4 次股票回购计划，累计回购股份达 45,176,472.00 股，累计回购金额超过 6 亿元。同时，为保护投资者权益，增强投资者信心，公司已注销 32,642,172 股回购股份。后续公司如有新的回购计划将及时公告。</p>

	<p><b>【问题】</b>公司在应用至手机的产品有哪些？</p> <p><b>【回答】</b>公司目前用于智能手机量产出货的模组包括：WiFi 模组、UWB 模组、5G 毫米波天线模组、指纹辨识模组、屏幕显示模组、触控模组等，主要应用于全球最知名的消费电子品牌厂商的智能手机。</p> <p><b>【问题】</b>今年公司投资并购的情况如何？</p> <p><b>【回答】</b>公司在过去几年的并购投资活动中围绕公司核心业务的上下游，完成了多项海外公司及资产的并购；今年以来监管机构鼓励上市公司并购重组，公司也开始积极关注国内优质的并购标的。在股权投资方面，今年公司新增了对深圳精控集成半导体有限公司和 NeuroBlade 公司的股权投资，精控集成的主要产品是光模块控制芯片和 BMS AFE 芯片，NeuroBlade 公司的主要产品是智能加速卡。</p> <p><b>【问题】</b>去年公司完成了上海张江厂关灯工厂生产区域的升级，对公司在全球工厂的自动化能力有所帮助吗？</p> <p><b>【回答】</b>智能制造对提高公司的核心竞争力非常重要。公司智能制造团队在上海厂区积累的经验和能力，正在服务全球厂区及复制推广。发展自动化和智能制造也会是公司从今年开始的工作重点，根据全球各制造服务据点的实际需求加快提升智能制造能力，以提高生产制造效率。</p> <p><b>【问题】</b>媒体报道预计北美大客户 25 年推出摄像头版 AI 耳机，环旭电子根据过去 TWS 耳机与北美大客户合作的经验，摄像头版本的 AI 耳机所使用的 SiP 模组会不会比过往的传统普通的 TWS 耳机更多，从而带来 SiP 业务增量机遇？</p> <p><b>【回答】</b>公司根据客户产品的设计要求提供制造服务，增加新功能可能对 SiP 模组的集成度或工艺难度造成影响。</p> <p><b>【问题】</b>环旭电子成立微小化创新研发中心(MCC)，并推出突破性的 SiP 双引擎技术平台。该技术平台主要应用哪些领域以及产品上？</p> <p><b>【回答】</b>环旭电子 MCC 微小化创新研发中心，推出 SiP 双引擎技术平台，提供高灵活的系统</p>
--	---

封装解决方案，帮助客户突破产品的开发难题，此创新解决方案可针对不同的市场应用进行快速模块化设计。Printing Encap 为模块封装提供了创新的方法，透过在真空腔体中以液态密封胶印刷方式实现塑封，不需要定制模具，开发周期从 12 周大幅缩短至 1 周，是一个相当具有成本效益的制程技术。

**【问题】**全球目前已经进入 AI 周期，北美英伟达 AI 服务器主要是面向企业端的客户，环旭北美大客户的 AI 消费终端面向个人用户的市场其实会更加庞大，在过往每一次创新周期，北美大客户的消费终端都有强力的拉动效应，环旭在 iPhone、Watch、AirPods、iPad、MacBook 等产品都将大量使用环旭 SiP 封装，对于环旭来说，大客户进入创新周期是否意味着环旭的业务也会跟随进入一个周期性的高峰阶段？

**【回答】**环旭电子是 SiP 模组全球领先厂商，服务大客户十余年，公司生产的 SiP 模组已广泛应用于大客户的智能手机、智能手表、智能耳机、平板/电脑、头戴设备等产品中，随着大客户进入创新周期并带动其消费电子智能化升级，进而可能引领同行业其他厂商跟进这一趋势，相信未来会带来更多的业务机会。

**【问题】**公司的 AI 伺服器电源模组目前已经量产出货了吗？

**【回答】**公司关注 AI 服务器等快速成长的业务机会，也在加强研发投入，积极争取客户订单。

**【问题】**公司 SiP 封装模组有没有像国内客户推广！A 客户的国内外影响正在逐渐下降！也势必会给公司业绩带来承压！公司将如何破局？是否有提前布局其他客户？

**【回答】**公司长期注重客户开发，比如，拓展模组化产品的业务，与消费电子、汽车电子的厂商合作开发模组或模块产品，还有积极拓展国内外客户推动公司综合制造服务业务。相对于公司应用于手机上的 SiP 模组，公司在应用于智能穿戴，如 AR、VR、智能眼镜、手表等产品上的 SiP 模组潜在客户更多。

**【问题】**AI 赋能消费电子设备开启个人 AI 设备创新形态浪潮，各种头戴设备、AR/VR 眼镜、以及 AI 手机、PC 等等，在上述创新形态的设备里面，对于环旭 SiP 模组业务是否会有巨大

的推动作用？

**【回答】**各种头戴设备、AR/VR 眼镜、以及 AI 手机、PC 等消费电子产品对“轻、薄、短、小”的需求较高，增加 AI 功能后对硬件设计集成度的要求会进一步提高，相信 SiP 模组高集成度、高可靠性、低功耗的优点未来也会得到日益广泛的重视和应用。

**【问题】**市面上推出的 AI 眼镜是否需要利用环旭电子的 SiP 封装技术来实现 AI 眼镜对微小化、轻量化、高集成的技术要求？

**【回答】**AI 眼镜对轻薄短小、外观异形易于组装的要求高，SiP 模组技术能够满足这些需求且具备优势，公司的 SiP 模组产品已经在客户的类似产品上使用。

**【问题】**之前公司与客户合作开发的智能眼镜、AR/VR 相关产品的无线通信（BT/WiFi6E）与系统级模块，2022 年已经开始有产品出货。现在 AI 眼镜产品强势崛起，无线通信（BT/WiFi6E/WiFi7）与系统级模块能应用于 AI 眼镜上面吗？

**【回答】**公司无线通信 SiP 模组能够应用在 AI 智能眼镜产品上，2025 年将有相关产品量产出货。

**【问题】**公司在今年年初业绩交流回答投资者提问中，提到了 2024 年下半年公司收入成长将有双位数增长，2022~2025 年呈现 U 型复苏的态势，2025 年将有望更大幅度增长。并且又在年中的业绩沟通中再次提到，2025 年的成长收入将回到 2022 年水平。而根据近日的（十月二十九日贵公司接待机构调研公告）中提到公司遭遇“经营逆风”，对下半年经营目标造成影响。请问公司原来对 2025 成长收入将回到 2022 年水平，这个判断是否也会有所变化？请公司管理层阐述一下应对“经营逆风”的措施，以及这些措施实施后会产生的影响

**【回答】**为投资人能够更好的了解公司的经营状况，公司在业绩快报和季度报告中披露经营目标，但经营目标的实现具有不确定性，公司在每次披露经营目标时均根据最新的市场相应未来的经营目标进行动态调整。公司在 2024 年年初投资人线上说明会中有提出，“预期上半年营收同比持平，下半年营收同比增幅恢复到两位数”，而在第三季度投资人线上说明会中，鉴于公司关注到下游市场需求相较原预期放缓，工业类和车电类产品客户的需求下修，展望第四季度的营业收入环比下滑。公司披露经营目标时已说明，经营目标并不构成公司对

投资者的承诺，投资者不应过分依赖该经营业绩目标信息。针对这一状况，公司将从几个方面来应对当下获利下降的局面，兼顾短期的绩效，以及长期的投资布局：

1、通讯类产品：公司在 Wi-Fi、UWB 模块方面一直保持较为明显的竞争优势，公司将积极应对新的竞争局面，争取明年市场份额有所恢复；

2、消费电子类产品：中长期看，穿戴式产品的客户，对产品性能要求高，更愿意导入 SiP 技术，公司今年拿到的新开发项目持续增多，相比 WiFi 等通讯模块，新开发客户的穿戴式产品 SiP 模块，有望更快放量，带动该业务板块营收成长；

3、工业类产品：工业类的产品，需求相对稳定，利润率也比较高，环旭的技术具有一定的领先根基，因此长期而言，一旦库存消化到一定程度，需求自然会恢复。公司在墨西哥、越南、东欧投资布局的产能，得到海外客户的积极反馈，相信在需求恢复过程中，环旭将会有更多机会拿到增量订单。

4、汽车电子类产品：公司也加大了大陆市场的业务拓展力度，扩充了 Power Train 国内销售团队，已取得成效；Power Module 的部分除了在台湾生产之外，也准备于惠州厂投资新产线，争取国内汽车客户的订单，同时开发国内的供应链。

5、云端存储类产品：基于客户的需求，我们已经决定要从 Server PCBA 延伸进到 L10 系统组装，以加速成长，扩大市场份额。

**【问题】**北美核心大客户正式发布了 AI 端侧应用，未来随着北美核心客户的产品向 AI 领域全面迭代更新，其核心终端设备有望迎来颠覆性更新升级，环旭电子在 SiP 领域已经积累了多年的技术，随着 AI 设备轻量化，便携化的趋势，上述北美核心大客户产品全面迭代对公司来说意味着全新的重大机会吗？

**【回答】**在居家、工作、出行、社交等生活场景当中，AI 正在重新定义个人电脑、手机、智能穿戴等终端设备的功能，可以预见未来消费电子产品在交互方式、智能物联、智能感知、数据处理和传输以及智能服务方面，都还会有较多突破。消费电子全面智能化升级，离不开高带宽、低延时、易接入的新一代无线通讯技术，如 Wi-Fi7、UWB、毫米波等；此外，消费电子产品“轻、薄、短、小”的需求趋势，相信 SiP 模组高集成度、高可靠性、低功耗的优点未来也会得到日益广泛的重视和应用。环旭电子是 SiP 模组全球领先厂商，自 2021 年设立 MCC 部门专门服务客户开发模组化产品，公司生产的 SiP 模组已广泛应用于大客户的智能手

	<p>机、智能手表、智能耳机、平板/电脑、头戴设备等产品中，随着 AI 带动的消费电子智能化升级，相信未来会带来更多的业务机会。</p> <p><b>【问题】</b>大环旭是否会因为各大头部科技企业持续开发迭代高性价比款头戴设备以及智能 AI 眼镜带来的业务增长？除了通信模组以外，声学模组是否有机会应用于在上述产品？</p> <p><b>【回答】</b>公司提供制造服务的 SiP 模组已应用于客户的头戴设备和智能眼镜等产品中，并与客户建立长期稳定的合作关系。公司将积极配合客户需求，服务客户技术创新和产品升级，做好相关制程研发、产品联合开发、新产品导入和量产的各项工作。此外，除了通信模组以外，公司于 2022 年投资的深圳旷世科技有限公司主要从事高端无损音频业务，公司为其提供电流模音频放大器模组的制造服务。</p> <p><b>【问题】</b>公司股价低迷，股权集中，机构占比超过 85%，公司会不会考虑引入战投，或者其他部署，来更好地发展公司，回馈投资者？</p> <p><b>【回答】</b>公司长期稳健经营，致力于回报股东。公司上市以来，保持每年不低于 30%的分红率，未来将继续坚持；同时，自 2019 年以来已完成四次股票回购计划。公司未来仍将通过长期聚焦主业、实施高质量发展的战略、努力提升经营效率和盈利能力来提升公司经营质量，同时综合运用包括并购重组、持续分红及适时股份回购、扎实的信息披露和积极的投资者关系管理等方式提升和传递公司的投资价值。</p> <p><b>【问题】</b>今年年初三星发布了 Galaxy Ring，该戒指的亮点在于健康监测功能。对于 AI 戒指、AI 眼镜、AI 头戴设备、AI 耳机这种小型穿戴设备是否都需要环旭的 SiP 封装的通信等一系列微小化模组？</p> <p><b>【回答】</b>像 AI 戒指、AI 眼镜、AI 头戴设备、AI 耳机等穿戴产品都被 AI 赋予新功能，功能集成度提高对轻薄短小、外观异形易于组装的要求更高，SiP 模组技术能够满足这些需求具备优势，相信未来会带来更多的业务机会。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 12 日